

**第二十届中国覆铜板技术研讨会**

**邀 请 书**

**“第二十届中国覆铜板技术研讨会”定于2019年10月17日至10月19日在江苏省苏州市“苏州珀丽春申湖度假酒店” 召开。**

在5G设备及移动通信、汽车电子、智能制造、物联网等市场需求的驱动下，我国覆铜板在实现高频、高速、高导热、高可靠性产品研发生产的进程中，持续创新与技术水平都得到快速发展。当前，面对中美贸易战及国际贸易环境复杂多变的新形势，覆铜板企业产品结构亟待调整，通过技术突破及新市场的开拓实现产品升级换代，上下游携手共创、协同发展，加快实现高端、特种覆铜板及其原材料的国产化进程。

在此新形势、新驱动下，中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA）、中国电子电路行业协会覆铜板分会拟定于2019年10月17日至10月19日，在江苏省苏州市“苏州珀丽春申湖度假酒店”举办“第二十届中国覆铜板技术研讨会”暨“第六届中国挠性覆铜板企业联谊会”。

本届研讨会的主题是**“ 适应新形势、抓住新机遇、提升新水平 ”**。大会将邀请覆铜板行业及其上下游的业界专家作精彩报告。还有来自国内覆铜板行业及其上下游行业的专家、技术人员送选的优秀论文，对覆铜板制造的新技术、新工艺、新材料、新设备、新标准，以及未来覆铜板市场、技术的发展趋势，进行深入广泛的研讨。并在大会召开之际，颁发本届研讨会的“CCLA杯优秀论文奖”。

**热忱欢迎海内外覆铜板行业及上下游企业代表、业界人士届时光临。**

**热忱欢迎关注覆铜板行业发展的各界人士、机构光临此盛会。**

**主办单位及联络资讯：**

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA） 王晓艳 029-33335234

中国电子电路行业协会覆铜板分会 李 琼 021-54179011-605

**协办单位：**

苏州锦艺新材料科技有限公司

中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）

中国电子材料行业协会电子精细化工与高分子材料分会（ECMA）

中国挠性覆铜板企业联谊会

广东省线路板行业协会（GPCA）

深圳市线路板行业协会（SPCA）

台湾电路板协会（TPCA）

**宣传媒体：**

**杂志：**《覆铜板资讯》、《印制电路信息》、《电子铜箔资讯》 、《印制电路资讯》。

**网站：**  中国覆铜板信息网 [www.chinaccl.cn](http://www.chinaccl.cn/)

 CPCA网 www.cpca.org.cn

 中国电子铜箔资讯网 [www.chinaccfa.com](http://www.chinaccfa.com)

 PCB网城 [www.pcbcity.com.cn](http://www.pcbcity.com.cn)

 台湾电路板协会网 www.tpca.org.tw

 **赞助单位：**

南亚新材料科技股份有限公司 山东圣泉新材料股份有限公司

诺德投资股份有限公司 苏州巨峰新材料科技有限公司

广东生益科技股份有限公司 广东建滔积层板销售有限公司

苏州生益科技有限公司 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂

腾辉电子（苏州）有限公司 广东同宇新材料有限公司

 无锡赫普轻工设备技术有限公司 南通凯迪自动机械有限公司

 成都科宜高分子科技有限公司 江苏瀚高科技有限公司

 南通图海机械有限公司 江苏迪普实业股份有限公司

四川东材科技集团股份有限公司 西安昱昌环境科技有限公司

**会议日程:（附后）**

**《第二十届中国覆铜板技术研讨会》:** 2019年10月17日～19日。10月17日全天报到，10月18日（8:30～18:00）全天报告，19日疏散。

**《第六届中国挠性覆铜板企业联谊会》：**2019年 10月18日（13:30～15:00）。

**会议费用：**

费用包括：会务费、资料费、餐饮费等。会员单位代表：已交会员费单位1500元/人（未交会员费的单位1800元/人）；非会员单位代表1800元/人。参会代表可提前将会务费用汇至协会账户，如参会人员有变动，可随后退费或报到现场补交。

住宿：参会代表按会议优惠价提前自行与酒店联系预定房间：标间：368元/晚/间（含双早）；单间 368 元/晚/间（含早餐）。**预定住宿联系人： 徐金辉经理**  **13913148555 ，**费用自理。

**付款方式：**

**帐 户:中国电子材料行业协会**

**开户银行:工行北京香河园支行**

**账 号: 0200 0191 0900 0125 724**

注：提前汇款请在汇款之日将开票信息同会议回执一起发给会务组，收到汇款后即可开票邮寄，汇款时请附言“覆铜板会议会务费”，以便区分；现场现金缴费的请将开票信息同会议回执一起提前发到会务组，以便会议报到时及时开票。

**会 址：**

苏州珀丽春申湖度假酒店（江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路28号）

电话：0512-66838888

**会议酒店交通指南：**

1. 飞机：无锡苏南硕放国际机场，机场距会议酒店约22公里，乘车约50分钟可至酒店。
2. 高铁：苏州北站，苏州北站距离会议酒店约11公里，乘车约23分钟可至酒店。
3. 自驾车：苏绍高速行至黄埭立交下高速，约15分钟到达会议酒店。

**会务组联络方式：**

联系人：王晓艳 13609146084 ，029-33335234 ，13369111960

 董榜旗 15667263899

传 真：029-33335234

E-mail: ccla33335234@163.com

网站：[www.chinaccl.cn](http://www.chinaccl.cn/)

《第二十届中国覆铜板技术研讨会》组委会

2019年9月25日

**《第二十届中国覆铜板技术研讨会》**

**会议回执**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | **订房数量** |
| **代表姓名** | **职 务** | **手 机** | **电 话** | **E-mail** | **单人间** | **双人间** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **开票信息：名 称：** **纳税人识别号：****地 址、电 话：****开户行及账号：** |
| **注意** | 1. **房源有限，计划在苏州珀丽春申湖度假酒店住宿的代表，务请于2019年9月30日前自行与酒店联系预订房间！联系时请报“覆铜板行业协会会议”，即可享受优惠价格。酒店预定房间联系人：徐金辉经理** **电话**

**13913148555 。****2、请参会代表准确填写回执表各项信息，**[**将回执于10月15日前发至**](http://将回执于10月15日前发至)**ccla33335234@163.com****。了解研讨会最新动态请登录：[www.chinaccl.cn](http://www.chinaccl.cn)，或者直接联系会务组。** |

**10月18日大会会议日程表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **报告地点、报告人及报告题目** | **主持人** |
| **一楼  《玫瑰厅》** |
| 8:30～12:00 | 中国电子材料行业协会副理事长、覆铜板材料分会理事长 **张东： 致开幕词** | 祝大同 |
| 中国电子电路行业协会副理事长、覆铜板分会会长 **董晓军** **致词** |
| 苏州锦艺新材料科技有限公司总经理 **黄勇峰： 致欢迎词** |
| 颁发2019年“CCLA杯”优秀论文奖 （获奖人员合影留念） |
| 华为技术有限公司2012实验室主任工程师 **黄明利： 《发展中的5G通信对覆铜板及其原材料的新需求》** |
| 中兴通讯股份有限公司 技术质量工程师 **李敬科: 《5G系统产品PCB技术和材料需求》** |
| 中国电子科技集团公司第14研究所研究员级高级工程师 **杨维生：**  **《ADAS雷达感应器微波基板研发探讨》** |
| 中电材协覆铜板材料分会副秘书长、行业资深专家、高级工程师 **祝大同：《对高速覆铜板产品与技术开发的探讨》** |
| 苏州锦艺新材料科技有限公司研发总监 **胡林政**： **《5G市场驱动下新型填料的应用与研究》** |
| 佛山市英斯派克自动化工程有限公司经理 **章敬文**:  **《人工智能（AI）机器视觉系统行业应用深度解析》** |
| 12:00～13:30 | **自助餐 一楼西餐厅** | 董榜旗王晓艳 |
|  **CCL产品与技术报告专场 一楼《玫瑰厅》** |
| 13:30～18:00 | 杭州谱育科技发展有限公司销售经理 **周新奇**：  **《近红外分析技术在覆铜板行业应用》** | 师剑英 |
| 上海第二工业大学环境工程系主任 副教授 **高桂兰: 《与覆铜板制造相关环保标准编制的新要点解读》** |
| 国家电子电路基材工程技术中心 广东生益科技股份有限公司开发工程师 **孟运东：** **《一种聚苯醚改性的低介电损耗覆铜板的开发与应用》** |
| 南亚新材料股份有限公司研究中心技术部经理 **粟俊华： 《改性类BT树脂在覆铜板中的应用》** |
| 西安交通大学微电子系功能材料研究中心研究生**熊刚：《基于Fabry-Perot谐振腔的微波介电性能测试系统的研究》** |
| 苏州生益科技有限公司技术中心高级工程师 **戴善凯：**   **《二氧化硅对半固化片流动特性及覆铜板性能的影响》**  |
| 国家电子电路基材工程技术中心 广东生益科技股份有限公司工程师 **葛鹰：****《高频高速覆铜板介电性能项目的测试技术发展综述——印制电路板高频插入损耗测试技术现状分析》** |
| [浙江华正新材料股份有限公司](http://www.hzccl.com/Default.aspx)工程师 **应雄峰: 《一种防焊裂低模量铝基板》** |
| 中电材协覆铜板材料分会资深专家、教授级高工 **师剑英： 《浅析碳氢树脂类覆铜板的设计开发》** |
| **《第六届中国挠性覆铜板企业联谊会》暨CCL用材料报告专场 二楼 《明致1厅》** |
| 13:30～18:00 | 中国科学院长春应用化学研究所博士、副研究员 **郭海泉： 《5G高频柔性印制电路聚酰亚胺基材发展概述》**  | 范和平 |
| 中国地质大学（北京）材料科学与工程学院研究生 **武晓： 《透明FPCB用无色透明聚酰亚胺薄膜的阻燃化研究》** |
| 华烁科技股份有限公司电子材料事业部研发部副经理、博士 **陈文求：**  **《FPC基材用改性丙烯酸酯胶粘剂的制备与性能研究》** |
| 深圳市柳鑫实业股份有限公司工程技术中心副主任 **张伦强：**   **《汽车板小孔径钻孔技术研究》** |
| 教育部纳米矿物材料及应用工程研究中心、中国地质大学（武汉）材料与化学学院教授 **曾鸣：** **《高频低介电性主链苯并噁嗪树脂的分子结构设计与可控制备研究》** |
| 苏州巨峰新材料科技有限公司工程师 **吴涛： 《含磷活性酯固化剂的技术开发以及在高频高速覆铜板上的应用》** |
| 山东圣泉新材料股份有限公司技术中心主任**李枝芳：《新型芳烷基多马来酰亚胺树脂的合成及在封装载板上的应用》** |
| 四川东材科技集团股份有限公司、国家绝缘材料工程技术研究中心工程师  **支肖琼:** **《几种苯噁嗪树脂的性能比较及固化机理研究》** |
| 18:30～20:30 | **苏州锦艺新材料科技有限公司 招待晚宴 二楼《明致2厅》** | 谢斯璟王晓艳 |